

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Pangaea Connectivity Technology Limited

環聯連訊科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1473)

正面盈利預告 及業務最新消息

本公告乃由環聯連訊科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)刊發。

正面盈利預告

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及潛在投資者，根據對本集團截至二零二六年九月三十日止六個月(「本期間」)的未經審核綜合管理賬目作出的初步評估及本集團管理層目前可得的資料，本集團預期本期間將錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利不少於8,000萬港元，而於二零二五年同期則錄得本公司擁有人應佔未經審核綜合溢利約1,540萬港元。

本期間，本集團收益增長逾80%，主要由於本集團履行及交付大量200Gb/s磷化銦光電二極管(PD)產品銷售訂單所帶動。銷量及收益隨之增加，帶動本集團本期間純利增長逾400%。本集團目前每月交付約一千五百萬件PD產品，預計該交付量將於本財政年度下半年及下一個財政年度進一步增加。

本集團供應全面的光電及半導體元件組合，包括集成電路、激光器、光電二極管(PD)及相關器件，該等器件可實現AI數據中心應用及光互連中高速光800G/1.6T/3.2T模組內的電光與光電信號轉換。本集團的跨阻放大器(TIA)目前正接受客戶的認證，而CW激光器則處於樣品測試階段。

特別是，本集團的200Gb/s PD產品業務在本期間繼續受惠於強勁的市場需求。人工智能基礎設施持續發展，以及針對圖形處理單元(GPU)基礎設施的高速光連通性的需求日增，主要帶動此需求。本集團相信，對其PD產品的需求持續，加上現有的未完成訂單，將繼續為本集團的可持續發展提供堅實基礎。

業務最新消息

本集團高功率工業雷射業務貢獻日增，預期將進一步使其收益結構多元化、提高平均毛利率及交付豐厚盈利表現。

本集團近期與一家國內及全球領先的印刷電路板(PCB)雷射鑽孔設備製造商，就高功率雷射光源系統(包含雷射光源、供電、空氣靜化氣、電纜及相關配件)簽訂獨家供應協議。

該設備由一線製造商用於生產高層數高密度互連(HDI)印刷電路板及超HDI印刷電路板。該高功率雷射光源系統主要應用於1.6T/3.2T印刷電路板(PCB)雷射鑽孔及雷射電路結構化。

本集團已於二零二六年十月起開始交付產品，預計在截至二零二七年三月三十一日止財政年度交付不少於500件產品(預期收益不少於5,500萬美元)。除設備銷售外，本集團近期已擴充深圳的雷射激光器實驗室，以提供售後保養服務，包括雷射頭維修及更換。此舉將進一步開拓本集團的收益來源、提升實驗室職能及能力以及長期整體盈利能力，並培養長期的客戶關係。

AI數據中心及高速人工智能傳訊迅速擴張，正推動運算及網絡基礎設施進行重大升級。隨著超大規模人工智能系統頻寬的需求日增，業界正加速向1.6T和3.2T互連硬體轉型，同時採用更強大的人工智能GPU及先進的半導體封裝技術。該等系統需要日益複雜、高密度的PCB、HDI板，其電路更精密、鑽孔更精準，更強的光反饋抗阻力，且製造良率要求明顯更嚴格。因此，隨著人工智能基礎設施投資週期推進，對高速及高精度雷射加工(包括微鑽孔、細線電路結構化及其他精密製程)的需求預計將隨之增長。

在此背景下，本集團正處於戰略性有利位置，把握人工智能硬件供應鏈中日益加速的資本支出。本集團管理層預期，工業雷射業務將在不久將來成為關鍵的增長動力，並在未來數年於財務報表佔重大的溢利比例。

上文所披露的財務資料未經審核，乃基於董事會對本集團未經審核綜合管理賬目的初步審閱，該等資料未經本公司核數師或審核委員會審核或審閱。本公告所載資料或會有所變動及調整。因此，本集團於本期間的實際業績可能與本公告所載資料有所不同。股東及本公司潛在投資者務請參閱本集團預期於二零二六年十一月底前刊發的中期業績公告。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
環聯連訊科技有限公司
主席
馮銳江先生

香港，二零二六年十月十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馮銳江先生、梁筠倩女士及黃偉枕博士；非執行董事甘承倬先生；以及獨立非執行董事凌國輝先生、伍成業先生及霍偉舜先生。